

# 2011-2012年全球及中国印制线路板行业研究报告

本报告主要研究硬质印制线路板(Rigid-PCB)。PCB是成熟产业，2010年其产值增幅达23.8%，是1998年后增幅最大的一年。2011年增幅放缓，只有5.9%。预计2012年继续放缓，只有大约4.0%。

PCB产业有独特之处，首先其是环保标准要求比较高，必须取得政府的排污执照。其次是高耗能产业，必须有充足、稳定的水电供应。再者，PCB是资本、技术、人力密集型行业，其技术涵盖化工、机械和电子，又需要大量使用专业的技术工人。因此PCB企业需要持续长期经营，一旦确定投资地，不易搬迁。

从2010年上半年开始，智能手机出货量大增，带动智能手机所需要的HDI板需求也大增，2010年下半年PCB大厂纷纷增加HDI产能。到了2011年第四季度，HDI板出现供过于求的迹象，HDI产能利用率开始下降。HDI板产能主要集中在台湾厂家，2011年由于台币对美元升值，按照美元计算的台湾PCB厂家收入都有不错的增长，按照台币统计则增幅不大。



苹果iPhone所使用的PCB板是HDI板中的最高级Anylayer型，其主力供应厂家都是台湾厂家。苹果的硬板PCB供应商众多，有日本厂家Panasonic、Ibiden和MEIKO；台湾厂家健鼎Tripod、欣兴Unmicron、华通Compeq；美国厂家Multek（珠海超毅）、以及奥地利厂家AT&S。台湾厂家对苹果的供应比例接近60%。

2011年PCB行业一个大变化就是纷纷向中国内地转移，湖北和重庆成为热门地区。投资湖北地区的主要有：日本MEIKO在武汉开始第三批投资，北京KDS在武汉投资，健鼎在仙桃投资，沪士电子在黄石投资。投资重庆的则有：GBM（精成科技）、AT&S、HannStar Board（瀚宇博德）。Huatao Electronics(华涛电子)在四川遂宁投资。Taiwan PCB Techvest (志超科技)在成都投资。Trendtronics在湖南湘潭、Huaxiang Circuit (华祥电路)在江西九江。

不过长三角仍然是PCB行业投资首选，昆山、无锡仍然有新PCB厂家投资，并且老的PCB厂家也未减产或转移，在内地设厂大多是策略性的，主力基地还在长三角。

对于PCB厂家来说，传统的PCB领域即使是Anylayer HDI，竞争都相当激烈，毛利率也在下降。相对而言，IC载板是PCB产品中毛利率最高的。IC载板在2002年由英特尔提供协助，日本厂家成功量产，制造工艺在50纳米以下的IC基本上都需要使用IC载板，早期只是局限在CPU和Graphics、Chipset领域。随着手机产业的发展，手机中的CPU、内存和应用处理器开始大量使用IC载板。尤其是CPU，高通所占比例甚高。进入4G时代，所有的手机CPU都要采用IC载板，否则发热量巨大。



手机之外，HDTV和机顶盒的MPU也必须采用IC载板，还有Basestation，高速Networking IC都需要采用IC载板。IC载板最大的市场仍是PC领域，基本上被日本厂家把持，2012年NGK退出，台湾的南亚线路板接替。不过PC领域已缺乏成长力度，且门槛很高。

IC载板领域早已不是蓝海，其竞争一样激烈，不过对于PCB大厂家来说，要想提高收入，就只能拓展IC载板领域。2012年全球第一大PCB厂家欣兴就加大对IC载板领域的投资，鸿海旗下的臻鼎也表示要进入IC载板领域。

NGK退出后，日本厂家只剩下Ibiden和Shinko。它们都以英特尔为主要客户，其报价高，Ibiden正在新建菲律宾基地，试图降低价格。Ibiden和Shinko以ABF载板为主，对于通讯领域的BT载板不感兴趣。韩国厂家中SEMCO是最全面的，一方面有Qualcomm的大量订单，另一方面其母公司三星电子也有相当多的IC需要采用载板封装，此外还有少量来自英特尔或AMD的订单。SIMMTECH以内存载板封装为主，该公司也是内存PCB板大厂。

台湾厂家中NANYA以英特尔主要客户，景硕以QUALCOMM和BROADCOM为主要客户，BT载板占90%。欣兴以Graphics IC为主。



## 2011年全球PCB硬板厂家收入前30名

厂家	地区	2011 年收入(百万美元)
UNIMICRON	台湾	2275
IBIDEN	日本	2052
ZDT	台湾	1654
TRIPOD	台湾	1442
TTM	美国	1429
HANNSTAR	台湾	1401
Nanya PCB	台湾	1324
SEMCO	韩国	1308
Shinko	日本	1059
CMK	日本	1006
DAEDUCK	韩国	971
MULTEK	美国	960
Viasystems	美国	866
COMTEQ	台湾	820
KINSUS	台湾	794
LG INNOTEK	韩国	781
MEIKO	日本	760
AT&S	奥地利	650
Elec&Eltek	香港	613
GCE	台湾	583
Chinpeen	台湾	574
TPT	台湾	567
SIMMTECH	韩国	553
UNITECH	台湾	507
WUS	中国大陆	487
Ellington	中国大陆	430
Dynamic PCB	台湾	406
Guangdong Goworld	中国大陆	321
Founder PCB	中国大陆	277
Gul Technologies	新加坡	237



# 报告目录

## 第一章、PCB产业概况

- 1.1、全球PCB产业产值
- 1.2、PCB产业近况与未来趋势
- 1.3、台湾PCB产业
- 1.4、中国大陆PCB产业
  - 1.4.1、中国大陆PCB产业规模
  - 1.4.2、2011年中国主要PCB企业投资项目与位置
  - 1.4.3、中国大陆PCB政策
- 1.5、欧洲PCB产业

## 第二章、PCB下游市场

- 2.1、手机
  - 2.1.1、全球手机市场
  - 2.1.2、手机品牌市场占有率
  - 2.1.3、智能手机市场与产业
  - 2.1.4、中国手机产业地域分布
  - 2.1.5、中国手机企业产量排名
- 2.2、笔记本电脑
  - 2.2.1、全球笔记本电脑市场规模与品牌格局
  - 2.2.2、平板电脑市场

## 第三章、PCB产业分析

- 3.1、手机PCB产业
  - 3.1.1、手机PCB厂家排名
  - 3.1.2、手机PCB配套关系
- 3.2、内存模块
- 3.3、光电板
- 3.4、汽车电子
- 3.5、笔记本电脑
- 3.6、IC载板产业
  - 3.6.1、IC载板简介
  - 3.6.2、IC载板趋势
  - 3.6.3、IC载板市场
  - 3.6.4、IC载板产业
- 3.7、全球PCB厂家排名

## 第四章、主要PCB厂家研究

- 4.1、欣兴
- 4.2、华通
- 4.3、瀚宇博德
- 4.4、金像电子
- 4.5、健鼎
- 4.6、名幸
- 4.7、CMK



4.7.1、无锡希门凯

4.7.2、瑞升科技

4.7.3、旗利得电子

4.8、IBIDEN

4.9、大德电子

4.10、TTM

4.11、耀华

4.12、AT&S

4.13、建滔

4.13.1、依利安达

4.13.2、科惠线路板

4.13.3、扬宣电子

4.14、SIMMTECH

4.15、志超

4.16、依顿电子

4.17、敬鹏

4.18、LG INNOTEK

4.19、SEMCO

4.20、方正电路板

4.21、高德电子

4.22、定颖

4.23、惠亚

4.24、南亚电路板

4.25、深南电路

4.26、沪士电子

4.27、超声电子

4.28、臻鼎

4.29、Multek

4.30、景硕

4.31、Shinko



## 图表目录

- 2006-2011年瀚宇博德收入与毛利率
- 2005-2011年金像电子收入与毛利率
- 2006-2011年健鼎收入与毛利率
- 2006-2012财年名幸电子收入与运营利润率
- 2010财年-2012财年上半年名幸电子收入下游应用分布
- 2010财年-2012财年上半年名幸电子收入技术分布by layer
- 2005-2012财年CMK收入与运营利润率
- 2007-2015财年CMK收入下游应用分布
- 2007-2011财年 CMK收入by layer
- 2007-2015财年 CMK收入地域分布
- 2006-2012财年IBIDEN收入与运营利润率
- 2006-2012财年3季度IBIDEN收入业务分布
- 2009-2012财年3季度IBIDEN运营利润业务分布
- 2008-2012年IBIDEN HDI板产量
- 2005-2012年大德电子收入与运营利润率
- 2009-2011年大德电子收入by business



- 2010年季度-2011年4季度大德电子收入by bunesiss
- 2005-2012年大德GDS收入与运营利润率
- 2010-2012年大德GDS收入业务分布
- 2009年1季度-2010年4季度TTM收入by technology
- 2006-2011年耀华收入与毛利率
- 2006-2012财年AT&S收入与EBITDA
- 2006-2012财年 AT&S产值地域分布
- 2011-2012财年 AT&S收入地域分布
- 2009-2011财年 AT&S收入下游应用分布
- 2011财年1季度-2012财年3季度 AT&S收入下游应用分布
- 2010年底依利安达各厂产能
- 2004-2009年扬宣多层板产量
- 2004-2009年扬宣双面板产量
- 2004-2012年SIMMTECH收入与运营利润率
- 2010年1季度-2011年4季度 SIMMTECH收入与运营利润率
- 2010年1季度-2011年4季度 SIMMTECH内存收入by speed
- 2010年1季度-2011年4季度 SIMMTECH载板 (Substrate) 收入产品分布
- 2004年1季度-2010年4季度SIMMTECH收入下游应用分布





- 2004-2010年SIMMTECH客户分布
- SIMMTECH厂区
- 2005-2011年志超收入与毛利率
- 依顿电子股权结构
- 2005-2011年敬鹏收入与毛利率
- 2010年4季度-2011年4季度LG INNOTEK每季度PCB业务收入
- 2010-2011年SEMCO收入部门分布
- 2010年1季度-2011年4季度SEMCO ACI事业部收入与运营利润率
- 2007-2011年方正PCB收入与运营利润率
- 2010年方正PCB下游应用分布
- 方正重庆厂产能by technology
- 珠海方正一厂产能by technology
- 珠海方正三厂产能by technology
- 珠海方正五厂产能by technology
- 方正杭州二厂产能by technology
- 珠海方正四厂产能by technology
- 高德电子关系企业
- 2006-2011年定颖收入与毛利率



- 2009-2012年定颖产能
- 2006-2011年惠亚收入与运营利润率
- 2008-2011年惠亚收入业务分布
- 惠亚全球分布
- 2008-2011年惠亚集团收入下游应用分布
- 惠亚主要客户
- 南亚电路板产能与全球分布
- 2010年南亚电路板客户结构
- 2007-2011年沪士电子收入与运营利润
- 2007-2010年沪士电子收入下游分布
- 2005-2011年超声电子收入与运营利润率
- 超声电子组织结构
- 2007-2011年超声电子收入业务分布
  
- 2011年传统PCB收入产品分布
- 2000-2012年全球PCB产业收入地域分布
- 2010-2011年全球PCB产业收入地域分布
- 2010-2011年全球PCB产业收入下游分布



- 2005-2011年台湾PCB产业收入产品分布
- 2000-2010年台湾PCB产业进出口值
- 2009-2010年台湾PCB产业收入下游应用分布
- 2004-2012年台湾手机PCB出货量全球市场占有率
- 2001-2012年中国PCB产业产值
- 2004-2011年台湾PCB厂家大陆产值产品分布2004-2011
- 2009-2010年台湾PCB厂家大陆产值下游应用分布
- 2005年3季度-2011年3季度台湾与中国每季度激光钻孔机销量
- 2010-2011年中国大陆PCB企业投资结构
- 2010年欧洲PCB厂家收入国别分布
- 2010年欧洲TOP50 -PCB厂家
- 2007-2014年全球手机出货量
- 2009年1季度-2011年4季度每季度全球手机出货量 与年度增幅
- 2010-2011年每季度全球主要手机品牌出货量
- 2010-2011年全球主要手机厂家出货量
- 2011年智能手机操作系统市场占有率
- 2011年1-11月中国手机产量各省分布
- 2011年45家中国手机厂家产量排名



- 2007-2013年全球笔记本电脑出货量与增幅
- 2010-2011年全球主要笔记本电脑厂家出货量
- 2010年4季度-2012年1季度全球主要笔记本电脑厂家市场占有率
- 2010-2011年手机PCB厂家排名
- 2010-2011年汽车电子PCB厂家收入市场占有率
- 笔记本电脑用PCB技术路线图
- 2011年笔记本电脑PCB板主要厂家市场占有率（按出货量）
- 2006-2015年IC载板所占PCB产业比例
- 2011-2012年IC载板下游应用比例
- 2010-2011年主要IC载板厂家收入
- 2009-2011年全球PCB硬板厂家收入前30名
- 2003-2011年欣兴收入与毛利率
- 2009年1季度-2011年4季度欣兴每季度收入与增幅
- 2010-2011年欣兴收入产品分布
- 2010-2011年欣兴收入下有应用分布
- 欣兴制造基地分布
- 欣兴历年合并
- 欣兴主要子公司2009-2010年财务数据



- 2006-2011年华通收入与毛利率
- 2010年1月-2012年1月华通每月收入与增幅
- 2009-2010年华通主要子公司财务数据
- 2010年1月-2012年1月金像电子 每月收入与增幅
- 2010-2011年金像电子收入产品分布
- 2010年1月-2012年1月健鼎每月收入与增幅
- 2006-2011年健鼎产能
- 2009-2011财年名幸电子大陆子公司收入与运营利润率
- 2003-2010年无锡希门凯收入与产量
- 2007-2011年揖斐电电子收入
- 2011年1季度-2012年1季度DAEDUCK收入产品分布
- 2004-2008年美维收入与运营利润
- 2005-2011年TTM收入与运营利润率
- 2008-2011年TTM收入下游应用分布
- 2008-2011年TTM收入地域分布
- 美维中国工厂一览
- 2010年1月-2012年1月耀华每月收入与增幅
- 硬板技术路线图



- 软硬板技术路线图
- AT&S基地全球一览
- 2011年AT&S各基地收入产品分布
- 2011年AT&S各基地产能
- 建滔集团组织结构
- 2002-2011年建滔集团收入与股东应占利润率
- 2008-2011年建滔集团收入业务分布
- 依利安达组织结构
- 2006-2011年依利安达收入地域分布
- 2006-2011年依利安达收入技术分布by layer
- 依利安达技术能力
- 2010年扬宣制程能力
- 2010-2012年SIMM TECH内存事业部收入产品分布
- 2010年 -2012年SIMMTECH载板 (Substrate) 收入产品分布
- 2010年1季度-2011年4季度 SIMMTECH产能
- 2010年1月-2012年1月志超每月收入与增幅
- 2010年志超客户结构
- 2007-2011年志超各厂产能



- 2007-2011年依顿电子收入与毛利率
- 2007-2010年3季度 依顿电子产量
- 2010-2011年依顿电子产能
- 2001-2010年依顿电子收入技术分布by layer
- 2007-2010年3季度 依顿电子收入by application
- 2007-2010年3季度 依顿电子收入by region
- 2007-2010年3季度 依顿电子收入客户结构
- 2010年1月-2012年1月敬鹏每月收入与增幅
- 2007-2010敬鹏各厂产能月产能(K SF)
- 2006-2011年LG INNOTEK收入与运营利润率
- 2010年4季度-2011年4季度LG INNOTEK收入产品分布
- 方正HDI技术能力
- 2005-2011年高德电子收入与运营利润
- 2010年1月-2012年1月定颖每月收入与增幅
- -2008-2011年惠亚主要客户
- 2009-2010年惠亚集团收入by destination
- 2006-2011年南亚电路板收入与毛利率
- 2010年1月-2012年1月南亚电路板每月收入与增幅



- 深南电路技术能力
- 2010年度沪士电子产品分层数情况如下表:
- 2007-2009年沪士电子出货量by layer
- 2007-2009年沪士电子收入by layer
- 2010年沪士电子主要客户
- 2007-2010年超声电子产量
- 臻鼎组织结构
- 臻鼎全球分布
- 2008-2012年臻鼎收入与运营利润率
- 2006-2011年1月底臻鼎员工数量
- 2011-2013年Multek ELIC技术路线图
- 2011-2013年Multek 软硬板 技术路线图
- 2011-2013年Multek Microvias技术路线图
- 2003-2012年景硕收入与毛利率
- 2010年1月-2012年1月景硕每月收入与增幅
- 2011年景硕收入产品分布
- 2011年景硕收入下游应用分布
- 2007-2012财年Shinko收入与净利润
- 2011-2012财年Shinko收入业务分布





# 购买报告

价 格	电子版：8500元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：9000元	传真：010-8260.1570
页数：185页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-03		网址：www.pday.com.cn
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201203/24511433.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201203/24511433.html</a>		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		



# 如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

([http://www.pday.com.cn/research/pday\\_report.doc](http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc)), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

# 版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

